DOCL	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KSU-603	製品仕様書	1⁄8
	DUCT N₀. JBBEO1O		Date : 202002
	neral 一般事項		
1.1 A	Application 適用單	囲 This specification is applied to TACT switch which have no key-top. この規格書は、キートップなしのタクトスイッチについて 適用する。	
1.2 C	Operating temperature r		·常圧)
		Operating temperature range shall refer to the range where this switch electrically ma	
120	Storage temperature ran	使用温度範囲とはスイッチがON-OFF機能を維持する温度範囲を言う。 ge 保存温度範囲: At Switch level 単品状態 - 40 ~ 90 ℃ (normal humidity, nor	mal air prasaura 赏识,赏压)
1.5 3	storage temperature ran	ge 保存温度範囲.At Switch level 早品次感 <u>40.00 _ 50</u> C (hormal humidity, hor Switch on Taping テーピング状態 −20 ~ 50 °C (humidity 湿度: 2	
1.4 T	est conditions 試験状		tests are as follows.
		試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Normal temperature 常 温: (Temperature 温度 5~35℃)	
		Normal temperature 常 温:(Temperature 温度 5~35 C) Normal humidity 常 湿:(Relative humidity 湿度 25~85%)	
		Normal air pressure 常 圧:(Air pressure 気圧 86~106kPa)	
		If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions	i.
		ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温 度: 20±2℃	
		Relative humidity 相対湿度: 60~70%	
		Air pressure 気 圧:86~106kPa	
		Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating. スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。	
		スイングは国路委板がら汗がないように取り付ける。	
		nsions 外観、形状、寸法	
2.1 A	Appearance 外観	There shall be no defects that affect the serviceability of the product. 性能上有害な欠陥があってはならない。	
2.2 S	Style and dimensions		
3. Тур	pe of actuating 動作形	式 <u>Tactile feedback</u> <u>タクティールフィードバック</u>	
4 Cor	ntact arrangement 回题	各形式 1 poles 1 throws 1 回路 1 接点	
			まは製品図による)
	ings 定格		
	Aaximum ratings 最大) Ainimum ratings 最小な		
5.2 1	Minimum ratings 12/1.7		
6. Eleo		気的性能	
6 1	Items 項目 Contact resistance	Test conditions 試験条件 Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made.	Criteria 判定基準 100 mΩ Max.
6.1	Bontact resistance 接触抵抗	Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え, 測定する。	<u>100 m</u> 52 Max.
		(1) Depression 押圧力: <u>10</u> N	
		(2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter or voltage	
		drop method at 5VDC 10mA. 1011-2011年2月日本語の時代は計画スは120-14-14年に際下は	
		1kHz微少電流接触抵抗計, 又はDC5V 10mA電圧降下法	
6.2	Insulation	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後, 測定する。	<u>100 M</u> Ω Min.
	resistance 絶縁抵抗	「記末件で試験を引うた後, 例とする。 (1)Test voltage 印加電圧: 100 V DC for 1 min.	
		(2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame,	
		between terminals and ground(frame)	
		端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間	
6.3	Voltage proof	Measurements shall be made following the test set forth below:	There shall be no breakdown.
	耐 電 圧	下記条件で試験を行った後、測定する。	絶縁破壊のないこと。
		(1)Test voltage 印加電圧 : <u>250</u> V AC (50~60Hz) (2)Duration 印加時間 : 1 min	
		(2)Duration 印加時間 : 1 min (3)Applied position 印加場所 :Between all terminals. And if there is a metal frame,	
		between terminals and ground (frame)	
		端子間、金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム	

DOCI	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE
	KSU-603	製品仕様書		2/8
	DUCT N₀. JBBEO10			Date : 202002
	Items 項目		Criteria	
6.4	Bounce バウンス	Test conditions 試 致 来 中 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時のバウンスを測定する。 Switch = 5V 5V 5V 5k Ω Oscilloscope オシロスコープ	ON bounce: <u>10 ms</u> OFF bounce: <u>10 ms</u>	Max.
7. Me	chanical specification	機械的性能		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判 定 基 準
7.1	Operating force 作 動 力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に徐々に荷重を加え, スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	<u>5.0</u> ± <u>0.7</u> N	
7.2	Travel 移 動 量	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Apply the specified static force to the center of the stem. Measure the switch travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に以下の静荷重を加え, スイッチがONするまでの距離を測定する。 (1) force 押圧力: <u>5.7</u> N	<u>1.04</u> ± <u>0.3</u> mm	
7.3	Return force 復 帰 力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部を移動量押圧後, 操作部が復帰する力を測定する。	<u>0.5</u> N Min.	
7.4	Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static force shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 50 N (2) Time 時間: 15 s 	Keep electrical ON/ 電気的にON-OFFす Item 6.1	
8. Env	vironmental specificatior	│	<u> </u>	
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判 定 基 準
8.1	Resistance to low temperatures 耐 寒 性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度40 + 2 ℃	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	

		(1) Temperature 温度: <u>-40</u> ± <u>2</u> ℃ (2) Time 時間: <u>1000</u> h (3) Waterdrops shall be removed.水滴は取り除く。	
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	Item 6.
	耐熱性	humidity conditions for 1 h before measurements are made:	Item 7.1
		次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。	Item 7.2
		(1)Temperature 温 度: <u>90</u> ± <u>2</u> ℃	
		(2)Time 時 間: <u>1000</u> h	
8.3	Moisture	Following the test set forth below the samp <u>l</u> e shall be left in normal temperature and	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):
	resistance	humidity conditions for 1 h before measurements are made:	<u>500 m</u> Ω Max.
	耐 湿 性	次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。	Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2):
		(1)Temperature 温 度: <u>60 _</u> ±_ <u>2</u> ℃	<u>10 </u> ΜΩ Min.
		(2)Time 時 間: <u>1000 h</u>	Item 6.3
		(3)Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> %	Item 6.4
		(4)Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1
			Item 7.2

temperature roor 温度サイクル drop 下記	製品仕様書 Test conditions 試験条件 er below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal		Date : 20200
Items 項目 3.4 Change of temperature roor 温度サイクル drop 下記			
	m temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water ps shall be removed. 記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 どし、水滴は取り除く。 A A B C C E E C C C E C C C E C C C E C C C C E C	Criteria Item 6. Item 7.1 Item 7.2	判定基準
hydrogen sulfide tem gas. (H ₂ S) thre 耐硫化ガス性 次の (1) (2) (3)	lowing the test set forth below the sample shall be left in normal apperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or ee times before measurements are made: D試験後,常温,常湿中に1時間放置し,2~3回操作後,測定する。) Concentration of H ₂ S gas. H ₂ Sガス濃度: <u>1</u> ppm) Temperature 温度: <u>40</u> °C) Relative humidity 相対湿度: <u>75</u> %) Time 時間: <u>240</u> h	Contact resistance <u>1</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1) :
sulfur dioxide. tem (SO ₂) thre 耐亜硫酸ガス性 次の (1) (2) (3)	lowing the test set forth below the sample shall be left in normal apperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or ee times before measurements are made: D試験後,常温,常湿中に1時間放置し,2~3回操作後,測定する。) Concentration of SO ₂ gas. SO ₂ ガス濃度: <u>10</u> ppm) Temperature 温度: <u>40</u> °C) Relative humidity 相対湿度: <u>75</u> %) Time 時間: <u>240</u> h	Contact resistance <u>1</u> Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1) :
保護構造 Let IP6X equivalent After IP6X相当 次の (1) / (2) ⁻ (3) 5	ust protection 保護(塵埃) the test samples be exposed to the below test condition. er the test, measurement shall be made. D(1)~(4)の試験後、測定する。 Amount of talc タルクの量: 2 kg/m ³ Time of circulation 循環の時間: 8 h Simply leave switch itself inside dust chamber. スイッチを試験装置室内に動作させずに放置する。 Dusts shall be removed. 表面の塵埃は取り除く。	Contact resistance <u>100</u> mΩ Max. No penetration of du inside of switch. 塵埃の浸入なきこと	
Let Mea 次の (1) [(hei スイ (2) [(3) \$ スイ	ater protection 保護(水) : the test samples be exposed to the below test condition. asurement shall be made after 1 hr soak at normal temperature/humidity. $D(1) \sim (4)$ の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 Depth of Immersion 浸漬深さ : 1 m ight from the top of switch and water surface (ッチの上端から水面までの距離) Duration of Immersion 浸漬時間 : 30 min 分 Simply leave switch itself inside water chamber. (ッチを試験装置室内に動作させずに放置する。 Water drops shall be removed. 水滴は取り除く。	<u>100 M Ω Min.</u> No outstanding pene effects the functiona	a 絶縁抵抗(Item 6.2) : etration of water which ality of switch. を与える水の浸入なきこと

DOCL	IMENT No. KSU-603	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 4/8
	UCT No. JBBE010	製品仕様書 	Date : 202002
9. End	urance specification Items 項目 Operating life 動作寿命	Measurements shall be made following the test set forth below: Contact res 下記条件で試験を行った後、測定する。 1 Ω Max (1) 16 VDC 50 mA resistive load 抵抗負荷 Insulation res (2) Rate of operation 動作速度: 2 to 3 operations per s 回/秒 10 MΩ M (3) Depression 押圧力: 5.7 N Bounce /ヾ (4) Cycles of operation 動作回数: 250,000 cycles 回 ON bounce Øperating frequency 00 perating frequency 10 MΩ M 00 perating frequency 10 M 00 perating frequency	esistance 絶縁抵抗(Item 6.2) : Min. ウンス(Item 6.4) : e: <u>20</u> ms Max. ce: <u>20</u> ms Max. orce 作動力(Item 7.1) : 6 of initial force して 動量(Item 7.2) : % of initial travel
9.2	Vibration resistance 耐振性	Measurements shall be made following the test set forth below: Item 6.1 下記条件で試験を行った後,測定する。 Item 7.1 (1)Vibration frequency range 振動数範囲: 10 ~ 55 Hz (2)Total amplitude 全振幅: 1.5 mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: 10 - 55 - 10 Hz Approx. 1 min 約 1 分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency : Logarithmic or uniform 前引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including the direction 振動の方向 of the travel (6)Duration 振動時間: 2 h each (6 h in total) 各 2 時間 (計 6 時間)	
9.3	Shock 耐 衝 撃 性	Measurements shall be made following the test set forth below: Item 6.1 下記条件で試験を行った後、測定する。 Item 7.1 (1)Acceleration 加速度: 980 m/s² (2)Acting time 作用時間: 6 msec (3)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: 3 times per direction 人 (18 times in total) 各方向各 3 回 (計 18 回) 回)	

DOCL	JMENT No. KSU—603	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 5/8
	JCT N₀. BBE010		Date : 20200
0. So	Idering conditions 半	 田付条件	
	Items 項 目	Recommended conditions 推 奨 条 件	
10.1	Hand soldering 手 半 田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: <u>350</u> °C Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田⊐テ容量: <u>60</u> W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと (5)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its topside. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。	
10.2	Reflow soldering リフロー半田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 部品表面温度(°C)	
		<u>260 </u> °C Max. <u>3</u> Peak Temperature	-
		180 150 150 <u>120 s Max</u> (Pre-heating 予熱) <u>3 ~ 4 min. Max.</u> Time inside soldering equipment 炉内通過時間 (2)Allowable soldering time 半田回数: <u>2</u> time Max.	
		(Z)Allowable soldering time 中面固成 · <u>-</u> time max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。)	
10.3	Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	 (1) Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 (2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2-V (SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2 同等品 (4) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this switch s flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを (5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you 	on. Therefore, when the PWB is たしげ等によりスイッチ側面から 設けないで下さい。

```
リノロー帽の裡類により、多少余件が異なりますので、手削に十分帷認の上使用してくたさい。
```

(6) As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible.

```
熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。
```

(7) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.

```
スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。
```

(8) The thickness of cream solder paste : 0.15 mm

クリーム半田印刷厚 :<u>0.15</u>mm



DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSU-603	製品仕様書	6/8
PRODUCT N₀. SKSUBBE010		Date : 202002
【Precaution in use】ご使用	 上の注意	I
A. General 一般項目 A1 For the export of produc	cts which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain a	oproval and/or follow the
formalities of such laws a	and regulations.	sprovar and, or follow the
国内外の輸出関連法規(こより規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。	
A2. Products must not be us purposes.	sed for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending	to use the products for such
軍事用途又はテロ等の反 へも当製品を一切供給し	え社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれ ないでください。	<i>い</i> がある法人・団体・個人等
such as AV (audio visual) equipment. The products other unauthorized use. V	se, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are so) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communic are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control eq With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representat	ation equipment or amusement quipment for aerospace or any and liability such as medical
system on the applicabili	ty. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire liability of the total system.	
従いまして、原子力制御 防災機器、海底用機器等	定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器 機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以 の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセッ フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設(l外で、医療機器、防犯機器、 ットでの十分な適合性の確認を
capacitive (C)), please le	d and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds t us know beforehand. 荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L),容量性負荷(C))で使用される場合は,	
B. Soldering and assemble to	o PWBoard process 半田付, 基板実装工程	
B1. Note that if the load is a	applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下	っさい。
_	shall be confirmed under actual production conditions. 定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。	
soldering after being mo	ed for reflow soldering, if you place it at the edge of PWB for convenience, then flux may get into the sliding p ounted, so do not apply auto dip after being mounted. ·田対応ですが, スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する	
十分にご注意下さい。		
-	eteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions り感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。	5.
	ss from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care. ed, any shock shall not be applied to the stem.	
ステムに横からの力が加	ロわりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 こ衝撃が加わらない様に注意して下さい。	
	d without any indication of switch floating between switch bottom and PWB. との間に隙間が生じないように取り付けてください。	
C. Washing process 洗浄工 C1 This switch shall not be	程 washable with solvents or like after soldering and/or touch-up soldering.	
	washable with solvents of the arter soldering and of couch up soldering. ・手直し工程時に、溶剤などでスイッチを洗浄しないでください。	
D. Mechanism design (switch	h layout)機構設計	

D1. When users use a different PWB mounting hole and land footprints/pattern from our recommended dimensions, the prior consultation shall be made with us. プリント基板取り付け穴およびパターンに関し、推奨寸法以外を採用する場合は、当社に連絡願います。

D2. You may dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a through-hole under and around the switch. 本スイッチをリフロー半田後, プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は, ディップ時のフラックス吹き上げ等により, スイッチ側面より, フラックスがはい上がる場合がありますので, パターン設計にあたっては, スイッチ下面, 周囲にスルーホールを設けないで下さい。

D3. Ultrasonic welding on the PWB assembly might cause broken switch due to vibration, depending on the welding conditions. e.g. broken calking, peeled dust/water proof sheet. In prior to implementation of such ultrasonic welding, please well check that welding process would not cause any issue to our product. タクトスイッチが搭載され機器の組立工程で超音波溶着を実施される場合は事前にタクトスイッチに異常が生じないか確認を行ってください。 超音波の条件により、スイッチに振動が加わりスイッチが破壊する可能性があります。不具合例:カシメ部破壊、防塵・防水シートの剥がれ。

D4. Switch shall not be kept pressed for a long time. スイッチを長時間 ON させる使い方はしないでください。

D5. This switch is not designed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such purpose, they shall verify such suitability with the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under their sole responsibility. The prior consultation with us is also needed. 本製品は長押しする用途で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡頂き、仕様内容を調整した上で採用可否判断願います。



図3: ストッパー位置の例

D13. When adding pre-travel to switch at module level to prevent wobble of set knob, pre-travel shall be set at 3.56mm or higher from switch bottom. In case pre-travel is set at lower than 3.56mm from switch bottom, it may potentially cause functional failure.

キートップのガタ防止の為、スイッチの初期押込みを設定される場合は、図4に示すようにスイッチ底面から3.56mm未満の位置に設定しないで下さい。 3.56mm未満の位置で設定した場合、動作せずになる可能性があります。



DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE				
KSU-603	製品仕様書	8⁄8				
PRODUCT No. SKSUBBE010		Date : 202002				
Please avoid using this switc 当スイッチは、直接人の操作	 D14. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation. Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section. 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は避けてください。 検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。					
D15. Please make sure that switc 基板がたわむような場所への	h is mounted without any flexure of PWB. D設置はお避け下さい。					
	way of the switch being used on your module, please let us know. い方が変更される際は当社に御連絡ください。					
care due to the switch perform	used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from autor mance might be affected. き生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそ					
同ーセット内に以下の様な部本 •For parts, rubber materia generate gas of sulfuriza 部品, ゴム材料, 接着剤 •When you use silicon rub form silicon dioxide coat シリコン系ゴム, グリーズ とSW接点部に2酸化珪	列, 合板, 機器の梱包材, 機器内の駆動部に使用される潤滑剤については, 硫化, 酸化ガスを発生しないものる ober, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low mo on the SW contact part, resulting in the contact failure. ス, 接着剤, オイルを使用される場合は, 低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シ 読素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。	を採用してください。 lecular siloxane gas may				
	il agents such as coating agents and greases to the products, please let us know beforehand. やグリース等の薬品を付着させる場合は, 別途ご相談ください。					
	atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among 可能性がある環境では, 端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならない					
F. Storage method. 保管方法						
_	onment shall be avoided. This product may face an increase in contact resistance and degraded solderability. 期間で保管されますと接触抵抗の上昇やはんだ付け性の悪化が発生する恐れがありますので避けてください					
−20℃~+50℃の範囲外の	(dgrs C, higher than +50 dgrs C, and∕or lower than 20%, higher than 85% humidity 2温度、または 20%~85%の範囲外の湿度					
(2)Corrosive gas 腐食性ガス (3)Longer than 6-month stor (4)Direct exposure to sunligh	age after being delivered 製品納入後6ヶ月超える長期保管。					
	opened, the remained products shall be repackaged and stored in the ALPSALPINE original packaging. アルプスアルパイン出荷時の梱包状態で保管してください。					
	in the ALPSALPINE original packaging without overstack or external stress that may potentially cause deforn な積み重ねや応力を避けてアルプスアルパイン出荷時の梱包状態のままで保管してください。	nation of packaging.				
	as released position, when they are stored. たままでの保存はしないでください。					
	lid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. を経過して, ご返却又はご発注の無い場合は, 無効とさせていただきます。					
	pecifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at or 法および取付寸法以外につきましては, 当社の都合により変更させて頂く事が有りますので, あらかじめ御了え					

G3. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire.

本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用を 禁止するか, 類焼防止対策をお願いします。

G4. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network.

スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故 障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全確保して頂きますようにお願いします。

G5. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策を して下さい。

G6. TACT Switch is trademark or registered trademark of ALPSALPNE CO., LTD. タクトスイッチはアルプスアルパイン株式会社の商標もしくは登録商標です。